

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成28年3月3日(2016.3.3)

【公開番号】特開2014-179473(P2014-179473A)

【公開日】平成26年9月25日(2014.9.25)

【年通号数】公開・登録公報2014-052

【出願番号】特願2013-52630(P2013-52630)

【国際特許分類】

H 05 K 3/46 (2006.01)

【F I】

H 05 K 3/46 H

H 05 K 3/46 S

【手続補正書】

【提出日】平成28年1月19日(2016.1.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0001】

本発明は、セラミック基板の製造方法および導体材料に関する。